

北京市金杜律师事务所
关于成都蕊源半导体科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（三）

致：成都蕊源半导体科技股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受成都蕊源半导体科技股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。就本次发行上市事宜，本所已出具《北京市金杜律师事务所关于成都蕊源半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）、《北京市金杜律师事务所关于成都蕊源半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）、《北京市金杜律师事务所关于成都蕊源半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书（一）》）和《北京市金杜律师事务所关于成都蕊源半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》（以下简称《补充法律意见书（二）》），现本所根据深圳证券交易所上市审核中心 2022 年 9 月 17 日下发的审核函（2022）010901 号《关于成都蕊源半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称《二轮问询函》）的要求，出具本补充法律意见书。

本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》（以下合称前期法律意见书）中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书；除非另有说明，本补充法律意见书中的报告期指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，报告期各期末指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日；除本补充法律意见书另有说明外，本所在前期法律意见书中所用名称之简称同样适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书中的出资比例、持股比例等若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

为出具本补充法律意见书，本所依据《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等有关规定，编制和落实了查验计划，亲自收集证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在发行人保证提供了本所为出具本补充法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料（包括原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料，无论该等资料是通过电子邮件、移动硬盘传输、项目工作网盘或开放内部文件系统访问权限等各互联网传输和接收等方式所获取的）是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，其所提供的副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料与其正本材料或原件是一致的和相符的；所提供的文件、材料上的签名、印章是真实的，并已履行该等签名和盖章所需的法律程序，获得合法授权；所有的口头陈述和说明均与事实一致的基础上，本所独立、客观、公正地遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了面谈、书面审查、实地调查、查询和函证、计算和复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。

本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》《首发上市法律业务执业细则》等规定以及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行上市相关事项进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次发行上市所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所仅就《二轮问询函》提及的有关法律问题发表意见，且仅根据中国境内现行法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证监会的有关规定发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见，其中如涉及到必须援引境外法律的，均引用发行人境外律师提供的法律意见。本所不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项及境外法律事项发表意见，在本补充法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告及境外法律意见的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市所制作的《招股说明书（申报稿）》中自行引用或按照中国证监会和证券交易所的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。

在本补充法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

中信证券	指	中信证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
华虹半导体	指	华虹半导体有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司

本所根据中国境内有关法律、行政法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本补充法律意见书如下：

一、 问题 4. 关于晶圆采购

申请文件及首轮问询回复显示，按照供应商 A 要求，发行人于 2020 年 3 月向供应商 A 支付保证金 33 万美元，发行人已于 2022 年 7 月支

付新增保证金 90 万美元。

公开信息显示，报告期后 8 英寸晶圆产能过剩，晶圆降价。

请发行人说明与供应商 A 就采购价格及采购量的约定情况、保证金相关具体条款、保证金退回条件、保证金未来可收回性、无法收回或持续以高价购买晶圆对未来财务数据的影响情况。

请保荐人、申报会计师、发行人律师发表明确意见。

（一）与供应商 A 就采购价格及采购量的约定情况、保证金相关具体条款、保证金退回条件、保证金未来可收回性

1. 与供应商 A 就采购价格及采购量的约定情况

根据发行人提供的订单及说明，并经本所律师对供应商 A 的访谈，截至本补充法律意见书出具日，发行人未与供应商 A 就最高/最低采购价格、最高/最低采购量进行约定。实践中供应商 A 基于整体市场情况及供需情况提供报价，发行人基于报价确定对应的产品型号及数量需求，双方通过订单形式交易，并在订单中约定采购价格、采购数量、交付地点等商务条款。

2. 保证金相关具体条款

（1）条款约定

根据供应商 A 业务人员向发行人发送的电子邮件内容，关于保证金的相关约定如下：

1) 第一笔 33 万美元保证金

于 2020 年 2 月 19 日通过邮件约定内容为：“贵司所提供的 USD330K 的保证金，请于近日内汇款至供应商 A 帐户（与 RY 付供应商 A 货款的帐户相同，请汇款后通知我们，我们财务会 check）。我们会在供应商 A SAP 系统内，独立 open 一个 RYchip 的保证金 account. 这笔钱我们双方都不会动用它，此金额是为提供 RY 的 payment

term 由 wafer start 付款延至 shipping 前一周付款的保证金。”

于 2020 年 2 月 24 日通过邮件约定内容为：“因 RYchip will provide 供应商 A USD330k for 保证金。待确认款项到位后，我们将 set up 一个独立 account for Rychip. 此笔保证金双方将不会动用。此保证金将提供 Rychip payment term 由原来的 wafer start 付款，延长为 shipping 前一周付款。”

2) 第二笔 90 万美元保证金

于 2022 年 6 月 24 日通过邮件约定内容为：“Rychip 在我们 8"fab 的投片越来越高，之前的保证金是在每月约 1000~1500pcs/m 的产出量来估算。未来 Rychip 在我们 fab 的产出可能达到 5000pcs~5500pcs/m 的量能。经过财务部的要求，我们需要 raise RY 的投片保证金额 USD900K. (原来 USD330K=>USD1.23M)。此金额之计算是以 5000pcs/m 的出货来估算。”

(2) 条款约定的法律效力

根据中国台湾地区理律法律事务所于 2022 年 9 月 28 日出具的《法律意见书》确认，“故该保证金约定合法成立且有效，蕊源科技集团及供应商 A 间存在合法有效之该保证金约定之法律关系。”

(3) 发行人支付保证金的目的

根据发行人的说明及本所律师对供应商 A 的访谈，发行人支付保证金性质为支付生产成本保证金款项，系为发行人的付款期限做担保及根据发行人的下单规模及需求情况提升保证金金额，目的并非锁定价格或产能，与采购价格、采购量等无关。

(4) 发行人支付保证金的商业合理性分析

根据发行人的说明，发行人支付保证金能够使得结算条款从下订单时点付款，调整为发货 (shipping) 前一周时点付款。从采购周期看，发行人从下订单至发货的平均周期约 104 天，扣除一周后，约为 97 天；从采购规模看，报告期各期，发行人向供应商 A 的采购规模合计约为 1.71 亿元，采购规模所需资金量较大。

因此，发行人通过支付一定的保证金，使得付款时点相对延后，能够有效节约

资金成本，具备商业合理性。

3. 保证金退回条件

根据供应商 A 业务人员于 2022 年 9 月 23 日发送的邮件确认：“当与贵公司不再交易合作时，且蕊源付清供应商 A 所有应付帐款后，供应商 A 会退还保证金；此外，保证金支付目的系结算条款变化所需，按照上述保证金约定条款，若未来贵公司选择还原回原有的下订单时即付款的模式，亦可收回保证金。”

根据中国台湾地区理律律师事务所于 2022 年 9 月 28 日出具的《法律意见书》确认，“故该保证金约定合法成立且有效，蕊源科技集团及供应商 A 间存在合法有效之该保证金约定之法律关系。”

4. 保证金未来可收回性

根据发行人的说明并经核查，根据供应商 A 2021 年度报告披露，其经营情况良好，资产规模较大，整体信用度较高，且向发行人收取的 123 万美元保证金占其资产总额比例较低，未来无法收回保证金的可能性较低。

因此，结合双方过往合作历史及对方访谈确认，假设未来双方不再交易合作，预计保证金可收回性较高。

（二）无法收回或持续以高价购买晶圆对未来财务数据的影响情况

1. 无法收回对未来财务数据的影响情况

根据发行人的说明及提供的支付凭证，发行人于 2020 年及 2022 年 7 月根据供应商 A 方面的要求，向供应商 A 支付保证金 33 万美元及 90 万美元，合计 123 万美元，对应账面余额分别为 221.48 万元人民币及 604.41 万元人民币。如前文所述，整体而言保证金无法收回的可能性相对较小。

鉴于本所律师非会计专业人士，本所及本所律师不具备就无法收回保证金对发行人未来财务数据的具体影响情况进行核查和判断的适当资格。

2. 持续以高价购买晶圆对未来财务数据的影响情况

(1) 发行人未与供应商 A 就最高/最低采购价格、最高/最低采购量进行约定，发行人不存在以高价采购晶圆的合同义务

如前文所述，截至本补充法律意见书出具日，发行人未与供应商 A 就最高/最低采购价格、最高/最低采购量进行约定，发行人不存在以高价采购晶圆的合同义务，相关保证金不属于预付款项，无需通过后期抵扣货款等与采购数量相关的方式收回。

(2) 发行人与供应商 A 的具体价格商议周期系按月为周期对下单价格进行动态商议调整，能够反映一定的市场变动情况，具备一定灵活性

根据发行人的说明，发行人与供应商 A 的具体价格商议机制为：供应商 A 每月基于整体市场情况及供需情况向发行人提供单层光罩报价，发行人结合所需产品型号对应的光罩层数进行初步测算，并向供应商 A 反馈型号及数量需求。双方以单层光罩报价及光罩层数测算的价格为基准，结合具体产品型号的供需情况，确定采购价格，发行人通过每月向供应商 A 下达订单的形式进行交易，并在订单中约定采购价格、采购数量、交付地点等商务条款。供应商 A 提供的每月单层光罩报价系其根据整体市场及供需情况进行动态调整，故双方之间的具体价格商议周期系按月为周期对下单价格进行动态商议调整，能够反映一定的市场变动情况，具备一定的灵活性。

根据发行人的说明及本所律师对供应商 A 的访谈，当晶圆产能持续紧缺时，晶圆供应商会适当提升晶圆采购价格，反之，当晶圆产能紧缺情况有所缓解时，晶圆采购价格亦将随之调降，即发行人与晶圆供应商将根据市场供需变动情况动态调节晶圆采购价格。结合目前 2022 年下半年起成熟晶圆产能有所松动的情况及晶圆采购价格的市场化变动规律看，预计未来发行人不会持续以高价购买晶圆。

经核查，发行人已在《招股说明书（申报稿）》“第四节 风险因素”之“三、经营风险”之“（七）原材料价格波动风险”补充披露如下：

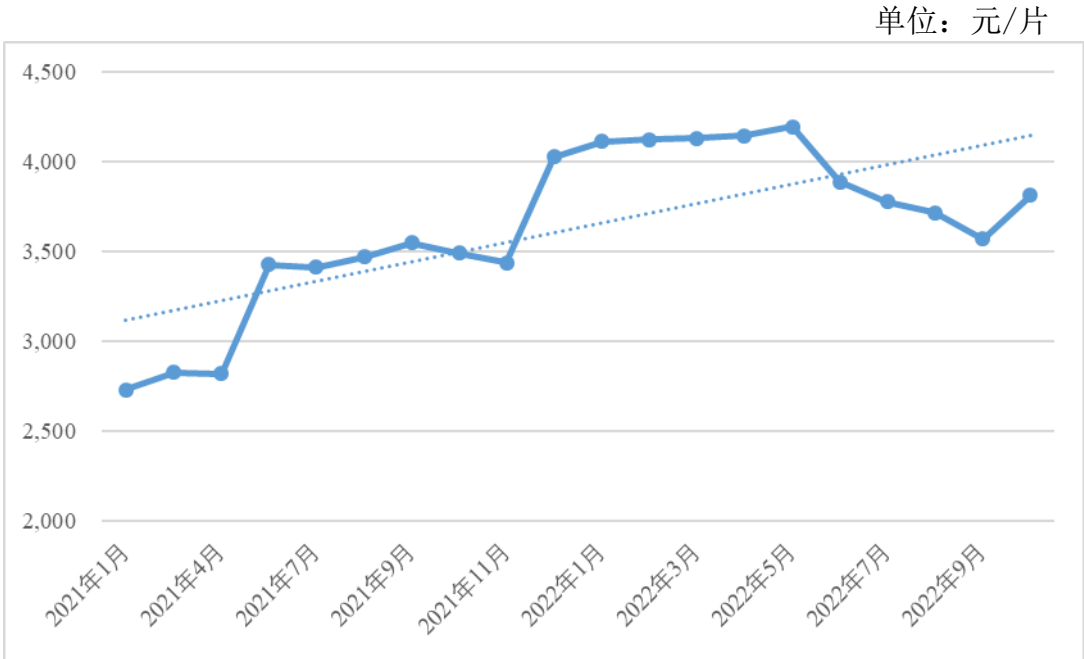
“（七）原材料价格波动风险

公司采购的产品和服务主要包括晶圆、封装测试服务、中测服务、封测原材料

等。2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，公司晶圆采购金额占公司当期采购总额的比例分别为 52.42%、60.21%、56.63%及 67.12%。公司原材料价格受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响，如果主要原材料采购价格出现大幅波动，将直接导致公司产品成本出现波动，进而影响公司的盈利能力。”

(3) 发行人晶圆下单价格波动情况与市场整体趋势总体保持一致

根据发行人提供的订单、说明及本所律师对发行人主要负责人、财务负责人的访谈，从蕊源有限/发行人晶圆下单价格波动情况看，自 2021 年 4 月开始，发行人对供应商 A 的晶圆下单价格逐步增长，至 2022 年 5 月订单单价达到峰值。自 2022 年 6 月开始，发行人对供应商 A 晶圆下单价格呈现下降趋势。蕊源有限/发行人对供应商 A 晶圆下单价格的走势图如下：



注：上述各月晶圆下单价格的计算口径为蕊源有限/发行人下达订单时晶圆的美元价格乘以年度平均汇率。同时上表部分月份无晶圆下单价格系该部分月份发行人未下订单。

从成熟制程晶圆价格变动趋势看，根据华虹半导体披露的定期报告，华虹 8 寸晶圆（以成熟制程为主）的销售价格自 2021 年初起至 2022 年第二季度，呈逐步提升趋势，与发行人对供应商 A 晶圆下单价格的趋势总体保持一致，具体情况如下：

项目	2022 年第 二季度	2022 年第 一季度	2021 年第 四季度	2021 年第 三季度	2021 年第 二季度	2021 年第 一季度
----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

项目	2022 年第二季度	2022 年第一季度	2021 年第四季度	2021 年第三季度	2021 年第二季度	2021 年第一季度
销售收入（千美元）	353,990	332,603	332,631	314,784	261,975	250,196
付运晶圆（千片）	567	571	617	622	546	541
平均销售单价（美元/片）	624	582	539	506	480	462
季度环比变动比例	7.18%	8.05%	6.53%	5.48%	3.75%	2.94%

注：华虹半导体暂未披露 2022 年第三季度数据

根据公开信息报道，2022 年三季度及之后的晶圆代工市场价格变动趋势情况如下所示：

发布机构及时间	报告内容
群智咨询 2022 年 8 月 23 发布《全球半导体芯片行业的六个趋势》	随着消费电子的需求走弱，预计部分晶圆代工价格将下行。具体来看，以驱动芯片代工价格为例，国产晶圆代工价格预计 2022 年第三季度稳中有降，第四季度下滑，这一价格下滑将延续到明年上半年。外资厂商如台积电、联电，其价格下滑幅度将明显低于国内晶圆厂。
奥维睿沃 2022 年 9 月 13 日发布《显示驱动市场下半年主旋律：以价保量》	数据显示，今年 Q3 DDIC 价格调整幅度在 10%左右，Q4 价格将在 Q3 价格上继续下调 5%-10%。 同样，目前在晶圆代工市场上的以价保量博弈也正在发生。受到前一年晶圆产能紧缺影响，DDIC 厂商与晶圆代工厂签订长约保障产能，在长约保护机制的连带影响下，目前晶圆代工厂产能利用率维持高位与供应链实际供需情况已然脱节，部分 DDIC 厂商在上半年已采取出货递延的方式应对市场变化，晶圆代工厂也开始感受到压力，为了能够保证现有的稼动率，开始接受 DDIC 厂商降价的需求。今年 Q3，部分

发布机构及时间	报告内容
	晶圆代工厂开始下调晶圆代工价格，下调幅度在 5%-10%，预计今年 Q4，晶圆代工价格将继续下调 5%以上。
半导体产业纵横 2022 年 9 月 26 日发布《8 英寸硅晶圆市况“急转直下”，12 英寸也难逃冲击》	今年以来，半导体产业进入新一轮库存调整周期，智能手机、PC 等消费电子需求疲软传导到产业链上游，使相关 IC 设计、代工厂等作出了客户将进行库存调整的判断，处于产业上游的硅晶圆市场，也隐隐感受到了市场的动荡。 有行业人士透露，近期 8 英寸硅晶圆市况率已出现了反转，而且是急转直下，后续 12 英寸硅晶圆产品也难逃冲击，引发环球晶圆、台胜科技、合晶科技等中国台湾厂商警戒。 8 英寸晶圆制程节点（含 0.35-0.11μm）产品主要为 DDIC（显示驱动 IC）、CIS（图像传感器）及 Power 相关芯片（PMIC、Power discrete 等）
中国台湾地区《经济日报》发布报道	半导体景气下行已延伸至最上游的硅晶圆材料领域。业界人士透露，近期 8 寸硅晶圆市况“急转直下”，后续 12 寸硅晶圆产品也难逃冲击，环球晶、台胜科、合晶等台厂警戒。其中，合晶 8 吋矽晶圆产品比重最高，恐率先感受市况波动，环球晶、台胜科也将逐步受影响。受半导体市场需求转弱冲击，业界人士指出，有部分矽晶圆厂商已同意一些下游长约客户的要求，可延后拉货时程。

整体而言，2022 年第三季度以来，成熟制程晶圆代工的产能利用率有所松动，根据公开报道，部分晶圆代工厂于 2022 年第三季度起下调一定比例的代工价格。结合前述分析，发行人对供应商 A 晶圆的下单价格自 2021 年起逐步提升，并在 2022 年 6 月起有所下降，与市场整体趋势总体保持一致。

（4）结合 8 英寸晶圆产能情况及发行人对供应商 A 下单采购价格变动情况分析对公司未来经营情况的影响

1）全球晶圆供需紧张正逐步缓解，但仍处于结构性紧缺状态，中芯国际、华

虹半导体等晶圆厂商仍维持较高的产能利用率

从晶圆代工行业整体情况看，根据中金公司 2022 年 6 月发布的证券研究报告显示，“目前，全球晶圆供需紧张正逐步缓解，但仍处于结构性紧缺状态，台积电、Samsung 等公司相继发布涨价函”。根据中芯国际于 2022 年 8 月披露的《2022 年半年度报告》显示，“2022 年上半年，在全球集成电路行业整体维持增长趋势的大环境下，各细分领域的市场上呈现多极分化，全球晶圆代工产能由全面稀缺转为结构性紧缺：（1）以智能手机、个人电脑为代表的存量市场需求逐渐放缓；（2）以物联网、数据中心、人工智能、新能源汽车等为代表的新兴增量市场对产能和技术创新提出了更高的要求；（3）行业对产业链区域性调整的预期依然存在，基于对供应链区域化分割的担忧，终端客户在地化生产需求加速，产生了在地化的产能缺口。”整体而言，晶圆产能供需紧张情况较此前趋于缓和。

从晶圆厂商的产能利用情况看，相关的行业研究及信息披露如下：

公司简称	内容
中芯国际	据中信证券2022年6月发布的研报显示： 1、中芯国际产能维持满产状态，利用率超过100% 公司近年来产能利用率较为平稳，近6年最低点为2017Q3的83.9%，2021Q2以来均保持100%左右或以上的满产状态，且公司预计2022年产能利用率有望继续维持高位（2022Q1公司产能利用率为100.4%）。当前行业主要表现为结构性紧张，中国市场的手机销售相对疲弱，出现取消订单状况，PC此前受益居家学习和居家办公的一轮逆势成长暂告一段落，但手机中电源管理、快充、WiFi6相关芯片仍然紧缺，中端CIS取代高端和低端CIS，PC增加了电源管理和WiFi6等需求。工业、汽车相关MCU仍然紧缺。8英寸晶圆方面MCU、PMIC、MOSFET持续紧缺，12英寸晶圆方面OLED驱动IC、MCU、WiFi 6等相对紧缺，因此预计2022年公司产能仍将满载运行。 2、晶圆平均价格逐季上涨，价格调涨与产品组合调整共同贡献

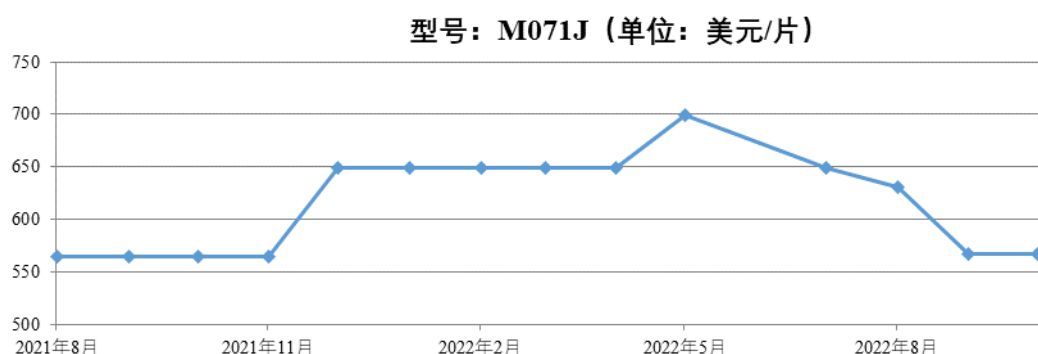
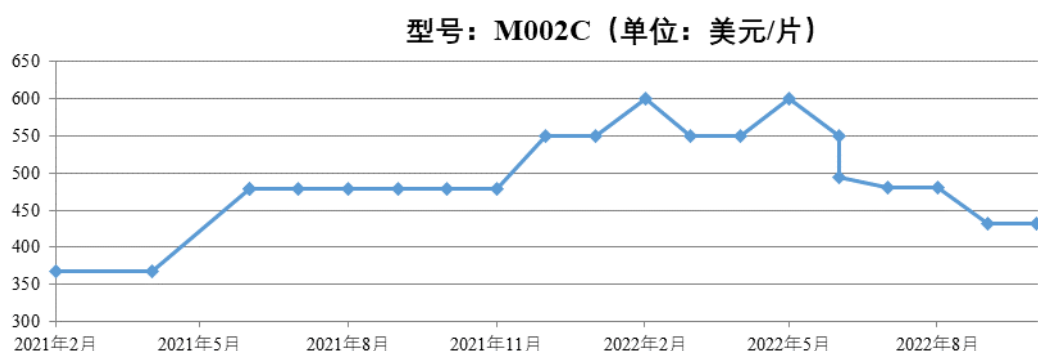
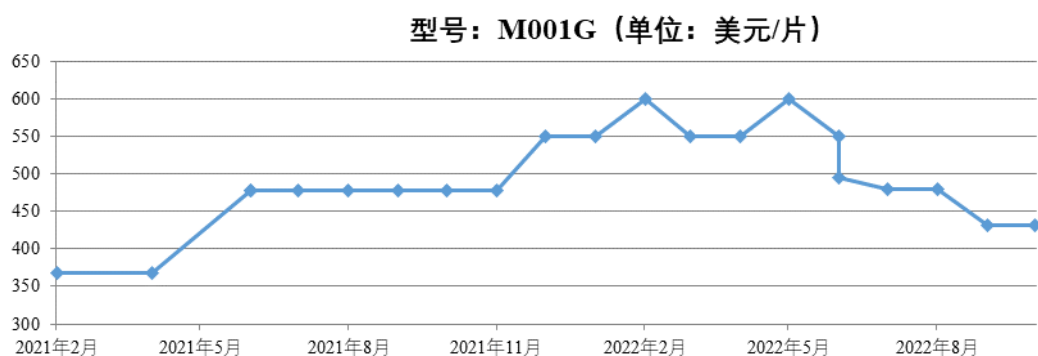
公司简称	内容
	在产能供应紧张，以及近期原材料如硅片、特种气体等涨价情况下，公司具备与客户协商价格的空间。根据Digitimes、集微网等媒体报道，2022年5月台积电、联电、三星陆续拟从2022下半年起抑或2023年开始上调代工报价，其中台积电或将于2023年1月起全面调涨代工价格5%-8%。2022Q1中芯国际的平均单价达到926美元/片（折合8英寸），环比上涨13%，其中涨价和产品组合调整影响大致各占一半。
华虹半导体	据光大证券 2022 年 5 月发布的研报显示： 2022 年第一季度公司 8 寸产线实现收入 3.33 亿美金，同比增长 33%，环比增长 3%；公司 8 寸厂房空间接近饱和，2022 年第一季度产能利用率 108% 继续维持高位。
杰华特	《杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》披露： 2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-57,036.40 万元，主要系受市场晶圆制造产能紧张影响使得公司在 2022 年上半年向中芯国际等支付产能保证金合计 32,557.10 万元。

资料来源：中信证券、光大证券等研究报告、《杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》。

从晶圆厂的扩产计划来看，根据平安证券 2022 年 8 月发布的研报显示，国内 8 英寸晶圆厂产能预计将从 2020 年的 80.5 万片/月扩产至 2023 年的 121.5 万片/月，增长 50%，晶圆厂持续投入产能建设。

2) 2022 年 6 月以来，发行人对供应商 A 下单采购价格已呈现下降趋势

根据发行人提供的订单、说明及本所律师对发行人主要负责人、财务负责人的访谈，以 M001G、M002C、M071J 为例，发行人历史采购下单价格变动趋势如下：



根据发行人提供的订单、说明及本所律师对发行人主要负责人、财务负责人的访谈，前述三个型号在 2022 年 1 至 6 月采购数量占发行人向供应商 A 合计采购数量的比例为 45.45%，相关型号的下单价格自 2022 年 6 月起均有所下降，2022 年 8 月下单价格较 2022 年 5 月已下降 3%至 20%，2022 年 9 月下单价格较 2022 年 8 月进一步下降约 10%，2022 年 10 月下单价格总体维持稳定。以 2022 年 1 至 6 月供应商 A 对发行人实际平均交货周期 126 天测算，预计发行人上述型号的采购价格（入库成本）将在 2022 年 9 月后呈现下降趋势。

3) 结合行业情况及近期晶圆价格变动情况看，随着 2022 年 6 月发行人对供应

商 A 晶圆下单价格逐步下降、未来趋稳，此前晶圆价格持续上涨带来的经营影响预计将逐步减弱

如前文所述，从行业整体情况看，产能方面，2022 年 1 至 6 月，中芯国际、华虹半导体等主流代工厂 8 寸晶圆产能利用率亦仍处于较高水平；晶圆价格方面，据相关研报显示，2022 年 1 至 6 月，晶圆采购价格总体并未呈现大面积下降的趋势，部分晶圆厂商价格仍有所上涨。总体而言，晶圆供需紧张正逐步缓解，但仍处于结构性紧缺状态，成熟制程晶圆的价格 2022 年上半年仍维持相对稳定，自 2022 年下半年开始产能有所松动。

根据发行人提供的订单、说明及本所律师对发行人主要负责人的访谈，从发行人向供应商 A 下单情况看，自 2022 年 6 月以来，主要晶圆型号下单价格已有所下降。从经营成果影响来看，发行人自晶圆下单、采购入库、销售及结转成本这一过程需要一定的时间周期，随着 2022 年 6 月发行人对供应商 A 晶圆下单价格逐步下降、未来趋稳，此前晶圆价格持续上涨带来的经营影响预计将逐步减弱。

（三）核查程序及核查意见

1. 核查程序

本所律师主要履行了以下核查程序：

（1）获取查阅公开信息及研究报告，了解半导体行业及主要晶圆厂商的近期发展情况、晶圆代工产能利用情况及晶圆代工价格波动趋势。

（2）获取查阅供应商 A 业务人员发送的邮件、供应商 A 年度报告等公开信息，确认与供应商 A 就采购价格及采购量的约定情况、保证金相关具体条款、保证金退回条件、保证金未来可收回性。

（3）获取查阅公司向供应商 A 的下单情况。

（4）获取查阅中国台湾地区理律法律事务所出具的《法律意见书》，确认发行人与供应商 A 间关于保证金约定的法律效力。

（5）取得发行人出具的说明。

(6) 访谈供应商 A、发行人主要负责人、财务负责人。

(7) 获取查阅《招股说明书（申报稿）》。

2. 核查意见

经核查，本所认为：

(1) 发行人未与供应商 A 就最高/最低采购价格、最高/最低采购量进行约定，发行人支付的保证金系为发行人的付款期限做担保，目的系节约资金成本，具备商业合理性。根据中国台湾地区理律法律事务所于 2022 年 9 月 28 日出具的《法律意见书》确认“蕊源科技集团及供应商 A 间存在合法有效之该保证金约定之法律关系。”保证金可收回性较高；

(2) 整体而言发行人无法收回保证金的可能性相对较小；发行人与供应商 A 的定价方式可确保发行人下单价格能够及时反映市场价格变动情况，现有定价方式不会导致发行人持续高价采购晶圆；发行人晶圆下单价格波动情况与市场整体趋势总体保持一致；随着 2022 年 6 月发行人对供应商 A 晶圆下单价格逐步下降、未来趋稳，此前晶圆价格持续上涨带来的经营影响预计将逐步减弱。

本补充法律意见书正本一式四份。

（以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于成都蕊源半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）》之签章页）

北京市金杜律师事务所



经办律师：

刘 滢

刘 滢

卢 勇

卢 勇

李 瑾

李 瑾

李 霄

李 霄

单位负责人：

王 玲

王 玲

二〇二二年十一月三日